

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成18年12月28日(2006.12.28)

【公開番号】特開2005-146008(P2005-146008A)

【公開日】平成17年6月9日(2005.6.9)

【年通号数】公開・登録公報2005-022

【出願番号】特願2003-381352(P2003-381352)

【国際特許分類】

C 08 G 63/16 (2006.01)

C 08 F 290/06 (2006.01)

C 08 F 299/04 (2006.01)

C 08 L 67/07 (2006.01)

H 01 L 23/29 (2006.01)

H 01 L 23/31 (2006.01)

【F I】

C 08 G 63/16

C 08 F 290/06

C 08 F 299/04

C 08 L 67/07

H 01 L 23/30 R

【手続補正書】

【提出日】平成18年11月10日(2006.11.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項1

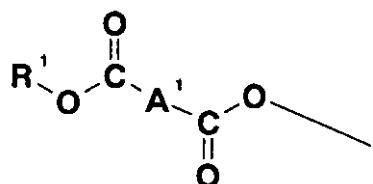
【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項1】

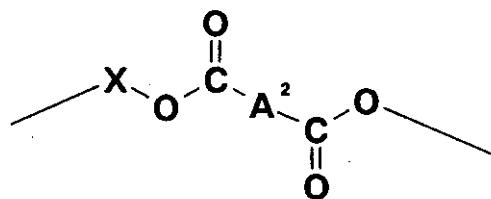
下記一般式(1)で表される基の少なくとも一種以上を末端基として有し、且つ下記一般式(2)で表される基を繰り返し単位として有する重合性化合物を含むことを特徴とする電子部品装置封止材用樹脂組成物に用いることができる熱硬化性樹脂。一般式(1)

【化1】



(式中、R¹はそれぞれ独立にアリル基またはメタリル基のいずれかを表し、A¹はそれぞれ独立に2価のカルボン酸から誘導される有機残基を表す。)一般式(2)

【化2】



(式中、 A^2 はそれぞれ独立に2価のカルボン酸またはカルボン酸無水物から誘導される有機残基を表し、Xは、それぞれ独立の有機残基であり、2個以上の水酸基を有する化合物から誘導された有機残基を含む有機残基を表す。ただし、Xはエステル結合によって、更に上記一般式(1)で表される基を末端基とし、上記一般式(2)で表される基を繰り返し単位とする分岐構造を有することが出来る。)

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0025

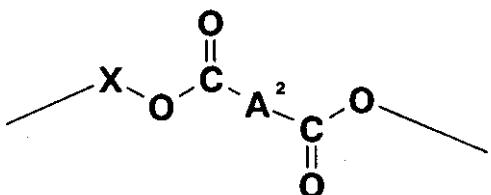
【補正方法】変更

【補正の内容】

【0025】

一般式(2)

【化2】



(式中、 A^2 はそれぞれ独立に2価のカルボン酸またはカルボン酸無水物から誘導される有機残基を表し、Xは、それぞれ独立の有機残基であり、2個以上の水酸基を有する化合物から誘導された有機残基を含む有機残基を表す。ただし、Xはエステル結合によって、更に上記一般式(1)を末端基とし、上記一般式(2)を繰り返し単位とする分岐構造を有することが出来る。)

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0031

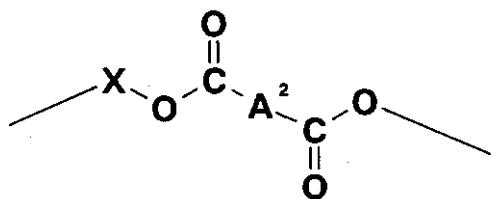
【補正方法】変更

【補正の内容】

【0031】

一般式(2)

【化4】



(式中、 A^2 はそれぞれ独立に2価のカルボン酸またはカルボン酸無水物から誘導される有機残基を表し、Xは、それぞれ独立の有機残基であり、2個以上の水酸基を有する化合物から誘導された有機残基を含む有機残基を表す。ただし、Xはエステル結合によって、更に上記一般式(1)で表される基を末端基とし、上記一般式(2)で表される基を繰り返し単位とする分岐構造を有することが出来る。)

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0048

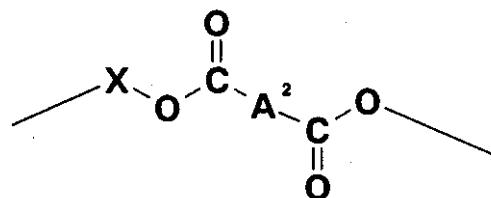
【補正方法】変更

【補正の内容】

【0048】

一般式(2)

【化6】



(式中、 A^2 はそれぞれ独立に2価のカルボン酸またはカルボン酸無水物から誘導される有機残基を表し、Xは、それぞれ独立の有機残基であり、2個以上の水酸基を有する化合物から誘導された有機残基を含む有機残基を表す。ただし、Xはエステル結合によって、更に上記一般式(1)を末端基とし、上記一般式(2)を繰り返し単位とする分岐構造を有することが出来る。)